

講演会のご案内

EU、米国の経済危機、1ドル75円に迫る史上最高の超円高、と日本を取り巻く状況は刻々と変化し、日本企業は海外展開を迫られています。アジアで企業活動は、中国、ASEAN諸国への進出が活発ですが、最近是人件費の上昇などにより中国展開は難しい状況になりつつあります。

本講演会においては、東アジアのビジネス、技術の動向に詳しいお二人の講師をお招きし、日本企業の進出が著しい台湾、中国などにおける最近の精密技術の動向についてご講演いただきます。

1. 日 時：2011年11月28日(月) 14時00分～16時30分
2. 場 所：九州工業大学 飯塚キャンパスAV講演室（共通教育研究棟1階）
（飯塚市川津680-4）
3. 参加費：無料
4. 対 象：一般、学生、教職員
5. プログラム
 - (1) ご挨拶 九州工業大学大学院情報工学研究院 教授 木村景一
 - (2) 演題：“Recent Trends on Taiwan’s Precision Machining of Wafer and Substrates for IC, PV and LED Industries”
講師：国立台湾科学技術大学 陳 教授（Professor Chao-Chang Arthur Chen）
内容：超 LSI、太陽光発電用太陽電池、LED などの基板として、シリコン、サファイアなどの高硬度材料基板が使用され、その精密加工技術が注目を集めています。従来は、これらの加工技術は日本のお家芸でしたが、台湾をはじめとするアジア諸国でも技術開発が進んでいます。最近のアジア諸国での技術動向をお話しいたします。
 - (3) 演題：「パラダイムシフト 20(10)：微細化・大口径化・3次元集積化は今！」
講師：株式会社 荏原製作所 取締役常務執行役員 辻村 学 氏
内容：半導体業界は過去 60 年、微細化（デナードの法則）と大口径化（ムーアの法則）によって発展し続けてきました。微細化は性能向上と生産性向上目的で2～3年ごとに、大口径化は生産性向上目的で約10年ごとに実施されてきています。2005年に大きなパラダイム変化がありました。それがパラダイムシフト 45 です。45nm、45cm、45mm という 45 という数字にまつわる大きな変化でした。本講演では、2005年に半導体業界を揺るがしたパラダイム変化とその後、そして今また訪れている 20 という数字にまつわるパラダイム変化を紹介し、半導体技術にとっての基礎、微細化・大口径化・3次元集積化の技術動向を紹介します。

主催：九州工業大学情報工学部

共催：日本機械学会九州支部（福岡東地区）

精密工学会プラナリゼーション CMP 専門委員会

お問い合わせ：大学院情報工学研究院 教授 木村景一

kimura@mse.kyutech.ac.jp